

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 吉澤六朗
講演企画委員長 有門経敏

2026 年度 11 月度フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。2026 年 11 月度フォーラムの開催案内をお送りいたします。今年から講演件数を 4 件以上に増やし、半導体のみならず半導体のアプリケーションも含めて幅広く情報を提供致しております。今年度第 4 回目は半導体の市場動向から先端半導体の日米・日韓の共同開発、さらには地政学リスクと経済安全保障まで幅広く取り上げました。それぞれに専門分野を詳しく解説して頂きます。また、講演件数の増加に伴い、従来無料であった会員（個人会員、準会員、賛助会員）の方々からも若干の参加費をいただくことに致しました。会員の皆様にはなにとぞご理解をお願い申し上げます。

記

1. 開催日時

2026 年 11 月 30 日（月） 13：00～19：00

2. 開催場所

林野会館（+オンライン）

所在地：〒112-0012 東京都文京区大塚 3-28-7

最寄駅：地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩 7 分

3. プログラム（講演時間には Q&A 10 分を含む）

13：00～13：50（50 分）『半導体も AI も一時的ブームではない大きな流れ』

国際技術ジャーナリスト 津田健二氏

13：50～14：40（50 分）『AI データセンターを手のひらに』

株式会社フローディア 奥山幸佑氏

14：40～14：50（10 分）休憩

14：50～15：40（50 分）『半導体の最先端とは何か？：高集積化の歴史から概観する』

広島大学半導体産業技術研究所 青砥なほみ氏

15：40～16：30（50 分）『AI 半導体時代の日韓共創：

日本の材料・装置・市場と韓国の HBM・量産力をつなぐ』

株式会社アイレゾン 堀井秀樹氏

16：30～17：20（50 分）『地経学リスクと経済安全保障 ～半導体ビジネスへの課題』

地経学研究所 田上英樹氏

17：30～19：00（90 分）懇親会（林野会館）

4. 講演内容

(1) 『半導体も AI も一時のブームではない大きな流れ』

講師：国際技術ジャーナリスト 津田健二氏

概要：2026 年半導体市場は確実に 1 兆ドルを超える。これまでパソコン⇒インターネット⇒スマホと変化してきたトレンドから AI へと確実に変化しているからだ。現在、AI はどの国でもスタートラインに立っている。AI はこれからあらゆる産業に拡大していく。すでに AI は DNN から生成 AI、リーズニング AI、エージェント AI へと拡大しつつある。その次は実物のマシンに AI を実装するフィジカル AI だ。近代的 AI の DNN が誕生してから AI を支えるテクノロジーがずっと半導体集積回路だった。この先もやはり半導体 IC だ。

かつては微細化が止まれば半導体の進展も止まると考える人たちが多かったが、今は半導体 IC への期待が大きく、もっと集積度を上げて性能と消費電力を改善してくれ、という要求はとても強い。CPU を IC に埋め込むことができるようになり、ソフトウェアを IC に埋め込めるようになると、人間の知恵 (ソフトウェア) を IC チップに埋め込むことで微細化とは別に進展し、ビジネスの限界は見えない。

講師略歴：

現在、国際技術ジャーナリスト 兼セミコンポータル編集長 兼 newsandchips.com 編集長。半導体・エレクトロニクス産業を 40 年以上取材。日経マグロウヒル (現日経 BP 社) を経て、Reed Business Information で EDN Japan、Semiconductor International 日本版を手掛けた。著書「エヌビディア」(PHP 研究所)、「半導体ニッポン」(フォレスト出版)、「知らなきゃヤバイ! 半導体この成長産業を手放すな」(共に日刊工業新聞社) など。



(2) 『AI データセンターを手のひらに』

講師：株式会社フローディア 奥山幸佑氏

概要：近年、AI を用いた推論のためのデータセンタでの消費電力は急激に増加して来ている。AI データセンタでの消費電力問題を抜本的に解決する手法として Computing in Memory (CiM) を開発中。推論における消費電力を 1/1000 に低減できる。AI 演算の GPU から CiM への転換はメモリと GPU 間の重みデータ転送の不要と微小電力 AI 演算 (積和演算) の双方を可能にする。この技術は弊社の SONOS 型不揮発性デバイス特有のメモリ性能 (データの保持精度、保持特性) によって可能になる。我々は更に CIM の 3D 化 (3D NOR) による大容量化を進めると共に、メモリのアレイ回路で可能になる記憶や推論以外の諸特性を利用し、知能として必要な学習能力、問題解決能力などを付加する試みを進めている。これらの技術はデータセンタを手のひらサイズに縮小し、移動体 (ドローン、自動車、ロボットなど) の体内に組み込むことを可能にし、大規模データセンタとの間の無線通信を必要としない完全自律型移動体を実現する。

講師略歴：

1973 年山形工業高校卒業、同年 3 月日立製作所入所、半導体デバイス信頼性解析、不揮発性メモリデバイスの開発などを担当。2003 年 (株) ルネサステクノ



ロジに異動。マイコンチップ搭載用 Flash メモリデバイス開発の取り纏めを担当。大容量高速 Flash メモリとして SONOS 型不揮発性メモリデバイスの製品化に成功。2011 年 3 月に (株) ルネサスエレクトロニクスを退社。同年 4 月 (株) フローディアを設立。不揮発性メモリの知的財産(IP) の開発/ライセンス業を開始。2017 年から CiM の開発に着手し、現在に至る。

(3) 『半導体の最先端とは何か？：高集積化の歴史から概観する』

講師：広島大学半導体産業技術研究所 青砥なほみ氏

概要：「半導体の最先端」と聞くとロジック半導体のゲート長〇nm を思い浮かべる人は多いだろう。その〇nm の数字が小さいことは最先端の要素の一つだが、寸法以外にもデバイス特性など重要な指標が多くあることを我々は知っている。たとえ寸法に着目しても、最先端は横方向寸法だけでは表せない。これら、誰もが知っていることを高集積化の歴史の切り口からレビューし、半導体の挑戦がどこにあるかを皆さんとともに再認識したい。また、多くの半導体産業人が関心を持つ「仕事スタイルのお国柄」を、限られた経験からではあるが日・米の違いを中心に紹介し、組織の合体に際して違いをいかに乗り越えるかについて語る。

講師略歴：

1983 年から 40 年間、半導体デバイスメーカーで開発に従事。業界再編で所属が NEC、エルピーダメモリ、マイクロンと変わる中、技術者、管理者、上級管理者として日米でデバイス・プロセス開発を牽引した。2023 年より広島大学特命教授、東北大学特任教授（客員）。大学・高専・高校や企業にて半導体の魅力や製造業で働く意義を伝え、優れた半導体人材を育成することを使命とする。また企業・組織におけるダイバーシティ（D&I、DEI）推進の意義と取り組み方について語ることも第二の使命とする。博士（工学）。



(4) 『AI 半導体時代の日韓共創:日本の材料・装置・市場と韓国の HBM・量産力をつなぐ』

講師：株式会社アイレゾン 堀井秀樹氏

概要：生成 AI の普及により、半導体産業の競争軸は、HBM、先端実装、材料、製造装置、電力を含む総合力へと移行している。日本は半導体材料、製造・検査装置、幅広い顧客市場で世界的な競争力を持ち、韓国は HBM、ファウンドリー、迅速な量産展開に強みを持っている。両国の技術と産業基盤には高い補完性があり、韓国のデザインハウスが日本の Preferred Networks と協力し、2nm 世代の AI 半導体の開発・量産に取り組む具体的な事例も生まれている。本講演では、サムスン電子での半導体研究開発・量産経験を基に、日韓企業の開発文化や意思決定の違い、協力を成功させる条件を解説する。材料・装置の韓国量産工程への導入、AI 技術の ASIC 化などを通じて、SSIS 会員企業の皆様が自社技術を日韓共創と世界市場へつなげる実践的な事業機会を提案する。

講師略歴：

大阪大学基礎工学部、ソウル大学大学院卒業後、サムスン電子に 29 年間勤務。半導体研究所を中心に、

ロジック・メモリ向け材料、プロセス、次世代メモリデバイスの研究開発から量産化まで幅広く担当。PRAM の製品化・量産（携帯電話 3000 万台搭載）、次世代メモリ、先端半導体デバイスの開発に携わるとともに、日本企業 20 社以上との材料・装置・デバイス分野における共同開発を推進。日韓企業間の技術要求、開発文化、品質基準、意思決定の違いを理解し、研究成果を量産・事業化へつなげてきた。現在はアイレゾン代表として AI 半導体、先端パッケージ、半導体材料・装置分野を中心に、日本企業と韓国のデザインハウス、半導体企業を結ぶ共同開発および事業化を支援している。JETRO KOREA 半導体分野アドバイザー。



(5) 『地経学リスクと経済安全保障 ～半導体ビジネスへの課題』

講師：地経学研究所 田上英樹氏

概要：世界情勢の不確実性が高まる中、地政学に経済の観点を含めて捉える地経学が重要視されるようになっている。ホルムズ海峡封鎖やトランプ関税、デュアル・ユース品、重要鉱物に関する経済的威圧 など、ビジネス界、半導体業界への影響も益々大きくなってきている。政府も経済安全保障を掲げ、様々な政策を打ち出し、民間をリードしたり、支援したりと官民連携が重視され、特に半導体関連では、従来以上に産学連携も重要になってきている。

そんな中、企業として、ビジネスパーソンとして、地経学リスクというものをどう捉え、どの様な経済安全保障の対応をしていくべきか、中々考えあぐねている向きも多いかと思う。本解説では、現在日本を取り巻く地経学リスクと企業に求められる経済安全保障、そしてそれらによって半導体ビジネスが今まさに受けている影響や課題について整理してお伝えする。

講師略歴：

地経学研究所 主任客員研究員。2024 年 5 月より地経学研究所にて現職。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、1992 年に総合商社入社。事業投資審査、与信取引審査、不動産事業審査、カントリーリスク分析、取引先格付、業界分析、産業メガトレンド分析、国内事業戦略、海外拠点 戦略等を担当し、2021 年より経済安全保障担当。2006 年～11 年間、総合商社シンクタンクにて、全事業分野に亘る業界分析業務に従事し、特に Value-Chain 分析を専門とする。

2015 年、東京大学 Executive Management Program 第 12 期修了

2015 年～2017 年、科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター事業評価委員

2017 年、文部科学省ナノテクノロジー・材料分野の研究開発戦略検討作業部会（第 3 回）にて

「2050 年に向けた産業メガトレンド」提言。

2025 年、経済産業省経済安全保障ガイドライン研究会委員

2026 年 6 月 参議院内閣委員会に参考人として出席、意見陳述

2025 年 11 月単著『地経学リスクからみた経済安全保障 20 の新常識：

日本企業のための基礎知識と部署別対応』を中央経済社より出版



5. 参加費

今年からできるだけ多くの方に興味を持っていただけるように講演件数を4件以上に増やし、それに伴って、SSIS 会員（個人会員・準会員・賛助会員）の聴講料を2,000 円/人、DAFS 会員企業の社員の聴講料を4,000 円/人、一般の方の聴講料を8,000 円/人とさせていただきます。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。なお、懇親会は3,300 円/人と致します。（参加費はいずれも消費税込み）

- 会員・準会員・賛助会員：講演聴講：2,000 円/人、 懇親会：3,300 円/人
（注：70 歳以上の個人会員は聴講費無料）
- DAFS 会員企業の社員：講演聴講：4,000 円/人、 懇親会：3,300 円/人
- 一般： 講演聴講：8,000 円/人、 懇親会：3,300 円/人

6. 申し込み方法

- ・ 申し込み受付開始：2026 年 10 月 1 日 ～ 締め切り：2026 年 11 月 16 日（月）17：00
- ・ 申し込みは下記 Google Form をご利用ください。

<Google Form>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftENnJ2qCvAlZGGsm800say2_SsOdJQLRWTQiQC28jPu0Y5w/viewform?usp=publish-editor

<Google Form をご利用されない方>

- ・ 申し込み締め切り：2026 年 11 月 16 日（月）17：00
- ・ 申し込み先：info@ssis.or.jp
- ・ 本メールに返信の形で事務局（info@ssis.or.jp）まで申し込みください。

【氏名】 _____ 【ご所属】 _____

（注）お申込者の氏名、所属については請求書、領収書の発行時の宛先となりますので、ご了承ください。

【領収書】

☐ 領収書を希望する ☐ 領収書は不要

【SSIS 会員、DAFS 会員、一般】

☐ SSIS 会員、 ☐ DAFS 会員【会社名： _____】、 ☐ 一般

【フォーラム】

☐ 林野会館で参加 ☐ リモートで参加

【懇親会】

☐ 参加 ☐ 不参加

7. 請求書・領収書について

- ・ 申し込み頂きましたら、SSIS の銀行口座を記載した請求書をお送りいたしますので、申し込んだ方（SSIS 会員、DAFS 会員、一般の方とも）はフォーラム参加費と懇親会参加費（懇親会参加希望者）をお振り込みください。
- ・ 請求書の宛先は、上記 6 項でご入力いただいたご氏名、ご所属となります。
- ・ ご入金を確認されましたら希望者には領収書を発行いたします。上記 6. 【領収書】の項目にチェックを

入れてください。

宛先は請求書と同じになります。なお、領収書の再発行はできかねますのでご了承ください。

また、但し書きは『SSIS 2026 年度第 4 回フォーラム聴講費及び懇親会参加費』となります。

懇親会に参加されない方につきましては『2026 年度 SSIS 第 4 回フォーラム聴講費』となります。

但し書きにつきまして、ご指定がございましたら下記にご記入ください。

但し書き： _____

8. その他

- ・ オンラインで参加を希望される方には、開催 1 週間前をめぐに、フォーラム参加費の振り込みを確認の上、オンライン接続情報 (Zoom) をお送りします。
- ・ お申し込みをキャンセルされる場合は、申込期限までをお願い致します。期限を過ぎた場合には、返金致しかねますのでご理解、ご了承をお願い致します。
- ・ ご質問がある場合は、事務局 (info@ssis.or.jp) までお問い合わせください。

一般社団法人 半導体産業人協会

<https://www.ssis.or.jp>

TEL : 03-6457-3245

FAX : 03-6457-3246
